

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2025年度备考合并财务报表及审阅报告



中微半导体设备(上海)股份有限公司

2025年度备考合并财务报表及审阅报告

内容	页码
审阅报告	1-2
备考合并资产负债表	1-2
备考合并利润表	3-4
备考合并财务报表附注	5-95
备考合并财务报表补充资料	1



审阅报告

普华永道中天阅字(2026)第 0001 号
(第一页, 共二页)

中微半导体设备(上海)股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”)按照备考合并财务报表附注二所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表、2025 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。按照备考合并财务报表附注二所述的编制基础编制备考合并财务报表是中微公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问中微公司有关人员和财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述备考合并财务报表没有在所有重大方面按照备考合并财务报表附注二所述的编制基础编制。

审阅报告(续)

普华永道中天阅字(2026)第 0001 号
(第二页, 共二页)

我们提醒备考合并财务报表的使用者关注备考合并财务报表附注二所述的编制基础的说明。本报告仅供中微公司为后附备考合并财务报表附注一所述重组交易之目的向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所报送文件时使用, 不适用于任何其他目的。本段内容不影响已发表的审阅结论。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海市
2026年3月30日

注册会计师

张炜彬

张炜彬

注册会计师

胡玉琢

胡玉琢

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2025年12月31日备考合并资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	附注	2025年12月31日
流动资产		
货币资金	五(1)	8,076,350,233.42
交易性金融资产	五(2)	843,115,787.42
应收票据	五(3)	60,589,092.80
应收账款	五(4)	2,149,161,922.16
预付款项	五(5)	68,905,728.84
其他应收款	五(6)	91,628,026.02
存货	五(7)	7,736,819,660.32
合同资产	五(8)	15,616,848.62
其他流动资产	五(9)	882,436,008.01
流动资产合计		19,924,623,307.61
非流动资产		
长期应收款	五(10)	12,242,089.36
长期股权投资	五(11)	1,444,770,418.51
其他非流动金融资产	五(12)	1,894,270,431.23
投资性房地产	五(13)	5,379,948.51
固定资产	五(14)	2,847,139,329.35
在建工程	五(15)	862,874,481.39
使用权资产	五(16)	20,764,247.30
无形资产	五(17)	1,573,019,248.94
开发支出	五(18)	1,535,060,685.12
商誉	五(19)	959,227,068.86
长期待摊费用	五(20)	6,410,943.82
递延所得税资产	五(21)	334,948,560.57
其他非流动资产	五(22)	446,407,302.48
非流动资产合计		11,942,514,755.44
资产总计		31,867,138,063.05

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2025年12月31日备考合并资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债和股东权益	附注	2025年12月31日
流动负债		
短期借款	五(24)	150,119,328.92
应付账款	五(25)	1,903,740,001.92
合同负债	五(26)	3,064,215,948.28
应付职工薪酬	五(27)	468,481,617.44
应交税费	五(28)	103,116,227.82
其他应付款	五(29)	586,898,670.56
一年内到期的非流动负债	五(30)	23,023,063.92
其他流动负债	五(31)	212,114,675.70
流动负债合计		6,511,709,534.56
非流动负债		
长期借款	五(32)	730,400,000.00
租赁负债	五(33)	11,806,891.72
预计负债	五(34)	10,264,753.04
递延收益	五(35)	169,810,277.96
递延所得税负债	五(21)	105,650.68
其他非流动负债	五(36)	4,988,385.00
非流动负债合计		927,375,958.40
负债合计		7,439,085,492.96
股东权益		
归属于母公司股东权益合计	五(37)	24,126,333,397.00
少数股东权益		301,719,173.09
股东权益合计		24,428,052,570.09
负债及股东权益总计		31,867,138,063.05

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

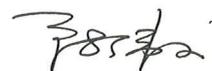
企业负责人: 尹志尧



主管会计工作的负责人: 陈伟文



会计机构负责人: 陈伟文



中微半导体设备(上海)股份有限公司

2025年度备考合并利润表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	2025 年度
一、营业收入	五(38)	12,628,757,057.36
减: 营业成本	五(38)、(43)	(7,746,897,056.31)
税金及附加	五(39)	(68,515,815.73)
销售费用	五(40)、(43)	(503,638,579.45)
管理费用	五(41)、(43)	(526,632,877.12)
研发费用	五(42)、(43)	(2,589,604,928.69)
公允价值变动收益	五(44)	161,353,145.46
信用减值损失	五(45)	(29,737,369.98)
资产减值损失	五(46)	(98,230,471.59)
加: 财务收入-净额	五(47)	43,941,146.60
其中: 利息费用		(23,724,464.76)
利息收入		102,494,516.74
其他收益	五(48)	270,330,946.06
投资收益	五(49)	513,715,801.36
其中: 对联营企业的投资收益		51,879,829.04
资产处置收益	五(50)	3,444,901.80
二、营业利润		2,058,285,899.77
加: 营业外收入	五(51)	9,549,345.02
减: 营业外支出	五(52)	(10,196,557.38)
三、利润总额		2,057,638,687.41
减: 所得税费用	五(53)	(125,632,065.02)
四、净利润		1,932,006,622.39
按经营持续性分类		
持续经营净利润		1,932,006,622.39
终止经营净利润		-
按所有权归属分类		
少数股东损失		(55,968,960.69)
归属于母公司股东的净利润		1,987,975,583.08
五、其他综合收益的税后净额		4,757,811.69
归属于母公司股东的其他综合收益/(损失)税后净额		
将重分类进损益的其他综合收益/(损失)		
权益法下可转损益的其他综合损失		(3,302,101.00)
外币财务报表折算差额		8,059,912.69
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2025年度备考合并利润表(续)
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	2025 年度
六、综合收益总额		<u>1,936,764,434.08</u>
归属于母公司股东的综合收益总额		1,992,733,394.77
归属于少数股东的综合损失总额		(55,968,960.69)
七、每股收益		
基本每股收益(人民币元)	五(54)	3.15
稀释每股收益(人民币元)	五(54)	3.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

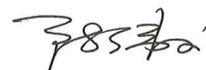
企业负责人: 尹志尧



主管会计工作的负责人: 陈伟文



会计机构负责人: 陈伟文



中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一 基本情况及重组交易方案

(1) 本公司基本情况

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身为中微半导体设备(上海)有限公司(以下简称“原公司”)由 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia(以下简称“中微亚洲”)于 2004 年 5 月 31 日在中华人民共和国上海市成立, 于 2018 年变更为股份有限公司, 并于 2024 年 8 月 9 日取得新营业执照统一社会信用代码 913101157626272806。

本公司于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所上市, 注册地址和总部地址为中华人民共和国上海市。于 2025 年 12 月 31 日, 本公司的总股本为 626,145,307.00 元, 每股面值 1.00 元。

本公司及子公司(“本集团”)主要开展的经营业务为研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及其他环保设备, 包括配套设备和零配件, 销售自产产品; 提供技术咨询、技术服务。

(2) 拟收购目标企业基本情况

杭州众硅电子科技有限公司(以下简称“杭州众硅”)是一家在中华人民共和国杭州市注册成立的有限责任公司, 注册地址位于浙江省杭州市临安区青山湖街道创业街 88 号 1 幢一层, 统一社会信用代码为 91330185MA2CC0D69L。

杭州众硅主要开展的经营业务为高端化学机械抛光(CMP)设备的研发、生产及销售, 并为客户提供 CMP 设备的整体解决方案。

2024 年 9 月, 本公司向杭州众硅出资 2,000 万元, 其中 84.2405 万元计入实收资本, 其他计入资本公积。

2025 年 2 月, 杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司及深圳市达晨财智创业投资管理有限公司向杭州众硅出资 15,000 万元。

2025 年 8 月, 淮安淮堃创业投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴芯通投资合伙企业(有限合伙)、杭州寓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)、吴仁德、南京星堃股权投资合伙企业(有限合伙)以及宁波领芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)将所持 10.2070%股份以 235,348,846.45 元价格转让给本公司, 转让完成后杭州众硅注册资本不变。本公司所持股数增加为 13,923,997 元。持股比例增加至 12.0429%。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一 基本情况及重组交易方案(续)

(2) 拟收购目标企业基本情况(续)

2026年3月, 杭州众硅以及杭州众硅现有全体股东(以下简称“投资人股东”)签署了《关于杭州众硅电子科技有限公司之股东特殊权利条款终止协议》(以下简称“《股东特殊权利条款终止协议》”), 就解除股东特殊权利事宜进行约定, 具体如下:

《股东特殊权利条款终止协议》所列全部交易文件中, 涉及的除委派董事/观察员权外的股东特殊权利条款(包括但不限于回购权/赎回权、反稀释权、优先认购权、优先购买权、优先清算权、限制出售权、检查权、知情权、最惠待遇权等, 具体条款内容详见交易文件具体约定), 自《股东特殊权利条款终止协议》生效之日起, 应被视为自生效之日起即不可撤销终止, 并自始无效, 对相关方无任何法律约束力。针对杭州众硅作为义务人承担义务的相关条款, 各投资人股东自成为杭州众硅股东之日起均不享有前述特殊权利, 杭州众硅自各投资人股东成为公司股东之日起不承担前述特殊权利所对应的义务, 且前述特殊权利条款在任何情况下均不会以任何形式要求恢复执行或视为自动恢复执行。

除杭州众硅作为义务人承担义务的相关条款外的其他投资人股东特殊权利条款, 在以下情况孰早发生日自动恢复效力: 1)重组交易未通过上市公司董事会审议; 2)重组交易未通过上市公司股东会审议; 3)重组交易签署后12个月内未向上海证券交易所(以下简称“上交所”)提交本次交易申请; 4)重组交易的申请未被上交所受理, 或上市公司撤回申请; 5)重组交易的申请被上交所或中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)否决, 或不予注册; 6)其他任何导致重组交易终止的情形。恢复时如相关条款已触发的, 其法定或约定的行权期限(如有)的起算时点均延后至恢复日。为免疑义, 任何涉及《股东特殊权利条款终止协议》约定附带自动恢复效力的条款在其效力恢复时的合同效力均不能溯及杭州众硅。附带自动恢复效力的条款无论在何情况下执行, 杭州众硅均自投资人股东成为股东之日起不承担任何义务也不对任何方承担连带赔偿责任。

即使有其他协议约定, 也以《股东特殊权利条款终止协议》约定为准。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一 基本情况及重组交易方案(续)

(3) 重组交易方案

于 2025 年 12 月 31 日和 2026 年 3 月 30 日, 本公司与杭州众芯硅工贸有限公司、上海宁容海川电子科技合伙企业(有限合伙)、杭州临安众芯硅企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州临安众硅管理咨询合伙企业(有限合伙)、杭州芯匠企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州众诚芯企业管理合伙企业(有限合伙)等 41 名交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》, 拟以发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅 64.69%股份(以下简称“重组交易”), 重组交易完成后, 杭州众硅将成为本公司的非全资子公司。本次重组交易的交易价格为人民币 157,604.91 万元, 其中人民币 152,346.38 万元由本公司以发行股份的形式支付, 人民币 5,258.53 万元以现金形式支付。该交易价格基于中联资产评估集团有限公司以 2025 年 12 月 31 日为评估基准日就杭州众硅全部价值的评估结果确定。对于本次重组中以发行股份支付对价的部分, 本公司将发行每张面值 1.00 元的股份 702.80 万份, 发行价格按照《中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》中披露的 216.77 元/股计算。2026 年 3 月 30 日, 上市公司第三届董事会第十次会议审议通过本次交易方案。

于 2026 年 3 月 30 日, 本公司与杭州众芯硅工贸有限公司、上海宁容海川电子科技合伙企业(有限合伙)、杭州临安众芯硅企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州临安众硅管理咨询合伙企业(有限合伙)、杭州芯匠企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州众诚芯企业管理合伙企业(有限合伙)、朱琳(以下简称“杭州众硅管理团队股东”)签署了《业绩补偿协议》。杭州众硅管理团队股东承诺, 业绩承诺期内杭州众硅 2026 年度、2027 年度及 2028 年度(以下简称“业绩承诺期”)各年度应实现的合并报表范围营业收入分别为 2.8 亿元、4.3 亿元及 5.8 亿元。如业绩承诺期每个会计年度结束后, 截至当期期末, 杭州众硅累计实现收入数小于截至当期期末累计承诺收入数的, 杭州众硅管理团队股东应按《业绩补偿协议》中约定的方式对本公司予以补偿, 优先以其在本次交易中获得的上市公司股份进行补偿, 不足部分以现金补偿。

本次重组交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准, 并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施, 能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 备考合并财务报表的编制基础

(1) 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》(以下简称“格式准则第 26 号”)的要求，本公司为附注一中所述重组交易向证监会及上交所进行申报之特殊目的编制本备考合并财务报表。本备考合并财务报表的报告主体为本次重组完成后的经扩大集团(即本集团及杭州众硅)。

(2) 本公司 2025 年度财务报表经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了普华永道中天审字(2026)第 10015 号的标准无保留审计意见。

杭州众硅 2025 年度财务报表经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了普华永道中天特审字(2026)第 0065 号的标准无保留审计意见。

(3) 本备考合并财务报表系假设附注一中所述的重组交易已经于 2025 年 1 月 1 日完成，并依据本次交易完成后的股权架构，以上述财务报表为基础，按照下述主要假设和附注三所述的主要会计政策和会计估计编制。

备考合并财务报表中采用的主要假设

(i) 假设于 2025 年 1 月 1 日，本公司已完成重组交易，重组交易完成后形成的组织架构于 2025 年 1 月 1 日已存在，即自该日起本公司已完成发行股份 1,523,463,831.91 元和应付现金 52,585,310.41 元，对价合计 1,576,049,142.32 元购买杭州众硅 64.69%股份。其中，本公司向交易对方发行股份数量 7,028,020 张，每张面值 1.00 元，发行价格按照《中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》中披露的 216.77 元/股计算。

(ii) 杭州众硅在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间发生的增资假设于 2025 年 1 月 1 日已经完成，相应的增资于 2025 年 1 月 1 日计入“其他应收款”，“股本”及“资本公积”。在增资款实际到账时，核销其他应收款。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 备考合并财务报表的编制基础(续)

备考合并财务报表中采用的主要假设(续)

- (iii) 杭州众硅历次增资的股东特殊权力自始无效。针对杭州众硅作为义务人承担义务的相关条款，各投资人股东自成为杭州众硅股东之日起均不享有特殊权利，杭州众硅自各投资人股东成为股东之日起不承担特殊权利所对应的义务，且特殊权利条款在任何情况下均不会以任何形式要求恢复执行或视为自动恢复执行。
- (iv) 在编制本备考合并财务报表时，合并成本与归属于本公司拟收购股份的杭州众硅 2025 年 1 月 1 日经备考调整后的可辨认净资产的公允价值之间的差额全部作为商誉。假设商誉在本报告期内未发生减值，故也未披露对该商誉进行减值测试的相关信息。
- (v) 在编制本备考合并财务报表时，假定业绩对赌条件满足，不考虑业绩对赌补偿的影响。
- (vi) 因募集配套资金而拟发行的股份及所募集配套资金，以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施，在编制本备考合并财务报表时不予考虑。
- (vii) 本备考合并报表未考虑本次重组中可能产生的交易成本、中介费用及相关税费的影响。
- (viii) 合并成本以及商誉的确认情况如下：

	杭州众硅
合并成本-	
发行股份	1,523,463,831.91
支付现金	52,585,310.41
以前取得的杭州众硅 12.04%份额的公允价值	293,845,920.01
支付对价合计	1,869,895,062.33
减：累计取得的杭州众硅可辨认净资产公允价值	
76.73%份额(附注六)	(910,667,993.47)
商誉	<u>959,227,068.86</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 备考合并财务报表的编制基础(续)

- (4) 基于编制本备考合并财务报表的特定目的，本备考合并财务报表仅列示本备考合并财务报表期间本备考主体的备考合并资产负债表和合并利润表。同时，本备考合并财务报表仅列示与上述备考合并财务报表编制基础相关的备考合并附注，未具体披露与本次重组无直接关系的金融工具及风险管理、公允价值以及资本管理等信息。本备考合并财务报表未列示本公司财务报表及其相关附注。
- (5) 备考合并资产负债表的股东权益按“归属于母公司股东权益”和“少数股东权益”列报，不再细分“股本”、“资本公积”、“其他综合收益”、“盈余公积”和“未分配利润”等明细项目。
- (6) 由于本次交易尚待本公司股东大会批准、上交所审核通过、证监会注册及其他有权监管机构的批准、核准或同意(如需)，最终经批准的本次重组交易，包括本公司实际发行的股份数量及其作价，拟置入杭州众硅的股东全部权益价值评估值、可辨认资产和负债的公允价值及其计税基础，以及业绩对赌实际完成情况都可能与本备考合并财务报表中所采用的假设存在差异，相关资产、负债及股东权益，包括商誉，都将在重组交易实际完成时根据实际情况相应调整。

固有限制

除上述所述的假设外，本备考合并财务报表未考虑其他与重组交易可能相关的事项的影响。本备考合并财务报表系根据假设附注一所述的重组交易已于 2025 年 1 月 1 日完成而形成的架构编制，其编制具有某些能够影响信息可靠性的固有限制，未必真实反映如果本次交易已于 2025 年 1 月 1 日实际完成的情况下本备考主体于 2025 年 12 月 31 日的合并财务状况、2025 年度(“本报告期间”)实际的合并经营成果。

如备考合并财务报表附注一所述，本公司董事会于 2026 年 3 月 30 日批准重组交易方案及根据重组交易方案编制的备考合并财务报表，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审阅，并出具了普华永道中天阅字(2026)第 0001 号的审阅报告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计

本备考主体根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量(附注三(8))、存货的计价方法(附注三(9))、投资性房地产的计量模式(附注三(11))、固定资产折旧、无形资产摊销和使用权资产折旧(附注三(12)、(15)和(25))、开发支出资本化的判断标准(附注三(15))、收入的确认时点(附注三(21))、股份支付(附注三(24))等。

本备考主体在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注三(27)。

(1) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(2) 重要性标准确定方法和选择依据

本备考主体结合自身所处的行业情况和生产经营特点，基于事项的性质和金额两方面综合判断相关财务信息的重要性。其中，根据该事项是否属于日常活动、是否显著影响财务状况、经营成果和现金流量等因素综合判断性质的重要性；根据该事项相关的金额及其占各项目金额、资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入和净利润等关键财务指标的比重综合判断金额的重要性。

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	坏账准备期末余额占应收账款期末账面余额 5% 以上且金额超过 10,000,000.00 元
重要的单项计提应收账款坏账准备的收回或转回	当期单项收回或转回金额占应收账款期末账面余额 5%以上且当期单项收回或转回金额大于 10,000,000.00 元
重要的在建工程	单个在建工程项目的预算金额大于 100,000,000.00 元
重要的投资活动现金流项目	单项投资现金流金额占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的 10%以上且大于 100,000,000.00 元
重要的联营企业	单项投资占本备考主体合并净资产的 5%以上且金额大于 1,000,000,000.00 元

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(3) 记账本位币

本备考主体记账本位币为人民币。本备考主体及下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

(4) 企业合并

(a) 同一控制下的企业合并

本备考主体支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本备考主体取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

本备考主体发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(5) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本备考主体开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(5) 合并财务报表的编制方法(续)

本备考主体内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。当相关子公司被处置并丧失控制权时，上述内部交易损益得以实现，本备考主体相应调整处置子公司的当期损益。

如果以本备考主体为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本备考主体的角度对该交易予以调整。

(6) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(7) 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(7) 外币折算(续)

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(8) 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本备考主体成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本备考主体根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：**(1)** 以摊余成本计量的金融资产；**(2)** 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；**(3)** 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本备考主体按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本备考主体持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(8) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(i) 分类和计量(续)

债务工具(续)

以摊余成本计量：

本备考主体管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本备考主体对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本备考主体将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本备考主体管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。本备考主体将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本备考主体将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(8) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(i) 分类和计量(续)

权益工具

本备考主体将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本备考主体将部分非交易性权益工具投资于初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本备考主体对于以摊余成本计量的金融资产和合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本备考主体考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本备考主体均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款和合同资产外，于每个资产负债表日，本备考主体对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本备考主体按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本备考主体按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本备考主体按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(8) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值(续)

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本备考主体假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本备考主体对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

按照单项计算预期信用损失的各类金融资产，其信用风险特征与该类中的其他金融资产显著不同。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本备考主体依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

关联方借款组合

押金组合

银行承兑汇票

商业承兑汇票

应收账款组合

其他组合

关联方借款

备用押金、保证金等信用风险较低的应收款项，以初始确认时点作为账龄的起算时点

信用等级较高的全国性银行

承兑人为一般企业

以初始确认时点作为账龄的起算时点

除以上组合以外的应收款项，以初始确认时点作为账龄的起算时点

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据，本备考主体参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、划分为组合的其他应收款和长期应收款，本备考主体参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(8) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值(续)

本备考主体将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本备考主体在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本备考主体将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本备考主体既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本备考主体的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款及长期借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本备考主体终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(8) 金融工具(续)

(c) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

(d) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本备考主体采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(9) 存货

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、发出商品和产成品，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。在同一地区生产和销售且具有相同或类似最终用途的存货，本备考主体备考主体合并计提存货跌价准备。其中，对于原材料，本备考主体根据库龄、保管状态及预计未来销售情况等因素计提存货跌价准备。

(d) 本备考主体的存货盘存制度采用永续盘存制。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(10) 长期股权投资

长期股权投资包括：本备考主体对子公司和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本备考主体能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算，除非本备考主体于初始确认时，结合对投资标的的投资意图、管理模式及业务性质等因素，将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本备考主体按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本备考主体负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本备考主体应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(10) 长期股权投资(续)

(b) 后续计量及损益确认方法(续)

本备考主体与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本备考主体的部分，予以抵销，在此基础上确认本公司财务报表的投资损益。在编制合并财务报表时，对于本备考主体向被投资单位投出或出售资产的顺流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本备考主体的部分，本备考主体在本公司财务报表抵销的基础上，对有关未实现的收入和成本或资产处置损益等中归属于本备考主体的部分予以抵销，并相应调整投资收益；对于被投资单位向本备考主体投出或出售资产的逆流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本备考主体的部分，本备考主体在本公司财务报表抵销的基础上，对有关资产账面价值中包含的未实现内部交易损益中归属于本备考主体的部分予以抵销，并相应调整长期股权投资的账面价值。本备考主体与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本备考主体及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注三(17))。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(11) 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物, 以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出, 在相关的经济利益很可能流入本备考主体且其成本能够可靠计量时, 计入投资性房地产成本; 否则, 于发生时计入当期损益。

本备考主体对所有投资性房地产采用成本模式进行后续计量, 按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时, 自改变之日起, 将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时, 自改变之日起, 将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时, 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时, 终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额(附注三(17))。

(12) 固定资产

(a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、计算机及电子设备、办公设备以及运输工具等。

固定资产在与其相关的经济利益很可能流入本备考主体、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(12) 固定资产(续)

(a) 固定资产确认及初始计量(续)

与固定资产相关的后续支出，在与其相关的经济利益很可能流入本备考主体且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10 - 70 年	5%	1.36%-9.50%
机器设备	3 - 7 年	0%-5%	13.57%-33.33%
计算机及电子设备	3 - 10 年	5%	9.50%-31.67%
办公设备	3 年	0%	33.33%
运输工具	5 年	5%	19.00%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注三(17))。

(d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(13) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注三(17))。

(14) 借款费用

本备考主体发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

(15) 无形资产

无形资产包括土地使用权、专有技术权、内部开发技术以及软件，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 专有技术权

专有技术按投资各方确认的价值入账，并按预计使用年限 10 年平均摊销。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(15) 无形资产(续)

(c) 内部开发技术

内部开发技术按开发阶段满足资本化条件发生的实际成本入账，并按预计使用年限 7 年平均摊销。

(d) 软件

购入的软件按照实际支付的价款作为实际成本，并按预计使用年限 3 年或者 5 年平均摊销。

(e) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(f) 研究与开发

本备考主体的研究开发支出主要包括本备考主体研发部门职工薪酬、实施研究开发活动而耗用的材料、股份支付费用、研发测试与维护费、研发使用的设备及软件等资产的折旧摊销等支出。

试制样机初步完成研制之前，为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；试制样机初步完成研制至大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(15) 无形资产(续)

(g) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注三(17))。

(16) 长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(17) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(18) 职工薪酬

职工薪酬是本备考主体为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本备考主体在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(18) 职工薪酬(续)

(b) 离职后福利

本备考主体将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本备考主体向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本备考主体的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本备考主体职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本备考主体以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本备考主体在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(c) 辞退福利

本备考主体在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本备考主体不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(19) 股利分配

现金股利于股东会批准的当期，确认为负债。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(20) 预计负债

因产品质量保证等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

(21) 收入

本备考主体在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

(a) 销售商品

本备考主体生产产品并销售予各地客户。

本备考主体将专用设备产品运至约定交货地点，进行安装、调试及验收。根据不同专用设备产品的类型及合同安排，经客户确认后，客户具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险，本备考主体于控制权转移至客户时相应确认收入。

本备考主体将备品备件产品按照协议合同规定运至约定交货地点，经客户确认后，客户具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险，本备考主体相应确认收入。

本备考主体给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本备考主体已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(21) 收入(续)

(b) 提供劳务

本备考主体对外提供劳务，通常根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本备考主体对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本备考主体按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本备考主体已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注三(8))；如果本备考主体已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本备考主体对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

(22) 政府补助

政府补助为本备考主体从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本备考主体能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本备考主体取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本备考主体将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。对于补偿特定研发项目的与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本；对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本备考主体对于同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(23) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本备考主体能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本备考主体内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本备考主体内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(24) 股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本备考主体为获取服务以自身股份或其他权益工具为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入当期损益，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本备考主体根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期损益。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本备考主体不确认成本或费用，除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

本备考主体修改股份支付计划条款时，如果修改增加了所授予权益工具的公允价值，本备考主体根据修改前后的权益工具在修改日公允价值之间的差额相应确认取得服务的增加。如果本备考主体按照有利于职工的方式修改可行权条件，本备考主体按照修改后的可行权条件核算；如果本备考主体以不利于职工的方式修改可行权条件，核算时不予以考虑，除非本备考主体取消了部分或全部已授予的权益工具。如果本备考主体取消了所授予的权益工具，则于取消日作为加速行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

如果本备考主体需要按事先约定的回购价格回购未解锁而失效或作废的限制性股票，本备考主体按照限制性股票的数量以及相应的回购价格确认负债及库存股。

以现金结算的股份支付，是指本备考主体因获取服务或商品、承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产义务的交易。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(24) 股份支付(续)

以现金结算的股份支付，本备考主体按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授权日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和负债。在资产负债表日，后续信息表明当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整；在可行权日，调整至实际可行权水平。本备考主体在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(25) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本备考主体作为承租人

本备考主体于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本备考主体将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本备考主体的使用权资产包括租入的房屋及建筑物及办公设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本备考主体能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本备考主体将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本备考主体选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(25) 租赁(续)

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本备考主体将其作为一项单独租赁进行会计处理：**(1)**该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；**(2)**增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本备考主体在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本备考主体相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本备考主体相应调整使用权资产的账面价值。

本备考主体作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

本备考主体经营租出自有的房屋建筑物时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本备考主体将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

当租赁发生变更时，本备考主体自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(26) 分部信息

本备考主体以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本备考主体内同时满足下列条件的组成部分：**(1)**该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；**(2)**本备考主体管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；**(3)**本备考主体能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本备考主体根据内部组织结构、管理要求以及内部报告制度将集团业务确定为一个经营分部进行分析评价。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(27) 重要会计估计和判断

本备考主体根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 开发支出

本备考主体在试制样机初步完成研制至大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足条件的(附注三(15))，予以资本化。不满足条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。

(ii) 预期信用损失的计量

本备考主体通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本备考主体使用内部历史信用损失经验及外部评级等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本备考主体考虑了不同的宏观经济情景用于估计预期信用损失的重要宏观经济假设包括生产价格指数、国内生产总值和行业预测等。本备考主体定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(27) 重要会计估计和判断(续)

(a) 重要会计估计及其关键假设(续)

(iii) 存货的跌价准备

存货的可变现净值是根据市场售价扣减相应的销售费用、合同履行成本以及相关税费进行估计的。这些估计是基于当时市况和产品销售的历史经验，可能由于市场环境变化而发生重大变更。管理层定期对此进行重新估计并相应进行调整。

(iv) 股份支付

于每个资产负债表日，对于完成等待期内的服务的权益工具，本公司根据最新取得的可行权员工人数变动等后续信息，对可行权权益工具数量作出最佳估计以及对某些特定情形作出最佳判断。

对于本公司授予的第二类限制性股票的股权激励计划，本公司聘请第三方估值机构协助采用期权定价模型评价确定限制性股票于授予日的公允价值，包括选择恰当的估值关键参数(包括无风险利率、波动率和预期股息率等)。

在计算股份支付相关费用时，本公司结合激励对象的等待期及对可行权数量的估计来分期确认相关的股份支付费用。

(v) 所得税和递延所得税

本备考主体在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本备考主体需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

如附注四(a)所述，本公司及部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及本公司的实际情况，本备考主体认为本公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来本公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(27) 重要会计估计和判断(续)

(a) 重要会计估计及其关键假设(续)

(v) 所得税和递延所得税(续)

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本备考主体以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本备考主体通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本备考主体在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

(b) 采用会计政策的关键判断

(i) 金融资产的分类

本备考主体在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本备考主体在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本备考主体在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(ii) 客户确认专用设备产品的时点

本备考主体根据合同安排以及专用设备产品安装调试、验收过程中是否需要不断调整产品设计规格及参数、后续发生成本是否重大、历史经验、客户确认情况等判断客户是否确认相关产品。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策和会计估计(续)

(28) 重要会计政策变更

财政部于 2025 年发布了若干《企业会计准则实施问答》(以下简称“实施问答”), 本备考主体一贯采用的会计政策与上述实施问答的原则一致, 该实施问答对本备考主体的财务报表没有重大影响。

此外, 财政部于 2025 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 19 号》, 并自 2026 年 1 月 1 日起施行。本备考主体预计执行该解释对本备考主体财务报表无重大影响。

四 税项

本备考主体适用的主要税种及其税率列示如下:

税种	计税依据	税率
企业所得税(a)	应纳税所得额	详见附注(a)
增值税(b)	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、9%及 13%
城市维护建设税(c)	缴纳的增值税税额	5%及 7%
教育费附加(d)	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加(d)	缴纳的增值税税额	2%

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 税项(续)

(a) 企业所得税

本备考主体按照《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“所得税法”)计算及缴纳企业所得税。

本公司及主要控股子公司适用的所得税率情况如下:

	注册地	2025 年度 适用税率
本公司(注 1)	中国上海市	15%
中微半导体设备(厦门)有限公司(“中微厦门”)	中国厦门市	25%
中微惠创科技(上海)有限公司(“中微惠创”)(注 2)	中国上海市	20%
南昌中微半导体设备有限公司(“中微南昌”)(注 3)	中国南昌市	15%
中微汇链科技(上海)有限公司(“中微汇链”)(注 4)	中国上海市	20%
中微半导体(上海)有限公司(“中微临港”)(注 5)	中国上海市	12.50%
中微科技投资管理(上海)有限公司(“中微科技”)	中国上海市	25%
芯汇康生命科学(上海)有限公司(“芯汇康”)(注 6)	中国上海市	20%
中微半导体设备(广州)有限公司(“中微广州”)	中国广州市	25%
超微半导体设备(上海)有限公司(“中微超微”)(注 7)	中国上海市	20%
中微半导体设备(四川)有限公司(“中微成都”)	中国成都市	25%
无锡正海缘宇创业投资合伙企业(有限合伙) (“无锡正海缘宇”)(注 8)	中国无锡市	不适用
杭州众硅电子科技有限公司(“杭州众硅”)(注 9)	中国杭州市	15%

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 税项(续)

(a) 企业所得税(续)

注 1：本公司为设立于上海浦东新区的生产性中外合资企业，依据所得税法的相关规定，公司适用的企业所得税率为 25%。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定，于 2024 年度，本公司获得高新技术企业认定，享受 15%的优惠税率，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2025 年本公司适用的企业所得税税率为 15%(2024 年度：15%)。

注 2：中微惠创为注册于上海的有限责任公司，该公司 2025 年度实际适用小型微利企业所得税税率为 20%(2024 年度：20%)。

注 3：中微南昌为注册于南昌的有限责任公司，依据所得税法的相关规定，公司适用的企业所得税率为 25%。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定，于 2024 年度，该公司获得高新技术企业认定，享受 15%的优惠税率，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2025 年该公司适用的企业所得税税率为 15%。

注 4：中微汇链为注册于上海的有限责任公司，该公司 2025 年度实际适用小型微利企业所得税税率为 20%(2024 年度：20%)。

注 5：中微临港为注册于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的有限责任公司，根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》规定，国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。2025 年该公司适用的企业所得税税率为 12.50% (2024 年度：12.50%)。

注 6：芯汇康为注册于上海的有限责任公司，该公司 2025 年度实际适用小型微利企业所得税税率为 20%。

注 7：中微超微为注册于上海的有限责任公司，该公司 2025 年度实际适用小型微利企业所得税税率为 20%。

注 8：无锡正海缘宇为注册于无锡的有限合伙企业，不适用企业所得税。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 税项(续)

(a) 企业所得税(续)

注 9：杭州众硅为设立于杭州的生产性企业，依据所得税法的相关规定，公司适用的企业所得税率为 25%。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195 号)有关规定，于 2022 年度，本公司获得高新技术企业认定，享受 15% 的优惠税率。2025 年 12 月 19 日更新了高新技术企业的证书认定，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2025 年度杭州众硅适用的企业所得税税率为 15%。企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转年限最长不得超过十年。

(b) 增值税

本备考主体的产品销售、提供应税劳务以及提供应税服务适用一般计税方法，适用税率为 13%、9% 及 6%。本公司注册于金桥出口加工区。本公司向金桥出口加工区外进行境内货物销售无需申报缴纳增值税销项税，本公司所缴纳的增值税进项税额亦无法抵扣。本备考主体境内子公司增值税应纳税额为当期销项税额抵减当期可抵扣的进项税额后的余额。

(c) 城市维护建设税

本公司及境内子公司按缴纳的增值税的一定比例缴纳城市维护建设税，本公司及下属子公司税率如下：

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 税项(续)

(c) 城市维护建设税(续)

	税率
本公司	5%
中微厦门	5%
中微惠创	5%
中微南昌	7%
中微汇链	5%
中微临港	5%
中微科技	5%
芯汇康	5%
中微广州	7%
中微超微	5%
中微成都	7%
无锡正海缘宇	7%
杭州众硅	7%

(d) 教育费附加和地方教育费附加

本公司及境内子公司按缴纳的增值税的 3% 缴纳教育费附加。

本公司及境内子公司按缴纳的增值税的 2% 缴纳地方教育费附加。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

2025 年 12 月 31 日

库存现金	156,044.10
银行存款(a)	7,777,448,607.35
其他货币资金(b)	267,930,439.29
应收利息	30,815,142.68
其中：存放在境外的款项总额	519,584,513.43
	<u>8,076,350,233.42</u>

(a) 于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体银行存款余额中包括七天通知存款 1,655,762,212.29 元。

(b) 于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体其他货币资金包括申购的结构性存款折合人民币 200,000,000.00 元、向银行申请开具海关税款保函及预付款保函所存入的保证金存款折合人民币 11,031,639.81 元、向银行申请开具信用证所存入的保证金存款折合人民币 30,390,799.48 元、ETC 信用保证金 8,000 元，以及其他受限资金折合人民币 26,500,000.00 元。

(2) 交易性金融资产

2025 年 12 月 31 日

结构性存款及银行理财产品	<u>843,115,787.42</u>
--------------	-----------------------

(3) 应收票据

2025 年 12 月 31 日

银行承兑汇票	61,200,063.80
减：坏账准备	<u>(610,971.00)</u>
	<u>60,589,092.80</u>

(a) 于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体无已质押的应收票据。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 应收票据(续)

(b) 2025 年度，本备考主体未对银行承兑汇票进行贴现。

于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体列示于应收票据的已背书但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票(i)	-	<u>62,611.04</u>

(c) 本备考主体的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(i) 于 2025 年 12 月 31 日本备考主体无单项计提坏账准备的应收票据。

(ii) 组合计提坏账准备的应收票据分析如下：

	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期 预期信用损失率	金额
银行承兑汇票	<u>61,200,063.80</u>	1.00%	<u>(610,971.00)</u>

组合 — 银行承兑汇票

于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，相关金额为 610,971.00 元，计入当期损益 610,971.00 元。本备考主体认为所持该组合内的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(iii) 2025 年度无实际核销的应收票据。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(4) 应收账款

2025 年 12 月 31 日

应收账款	2,228,761,038.38
减：坏账准备	(79,599,116.22)
	<u>2,149,161,922.16</u>

(a) 应收账款账龄分析如下：

2025 年 12 月 31 日

一年以内	1,762,987,683.18
一到二年	379,013,315.71
二到三年	71,821,361.68
三到四年	12,723,598.37
四年以上	2,215,079.44
	<u>2,228,761,038.38</u>

(b) 于 2025 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款和合同资产汇总分析如下：

	应收账款余额	坏账准备金额	占应收账款 余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	<u>1,449,813,982.62</u>	<u>(48,524,402.85)</u>	<u>64.58%</u>

(c) 于 2025 年度，本备考主体无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(d) 坏账准备

本备考主体对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(i) 于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体无单项计提坏账准备的应收账款。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(4) 应收账款(续)

(d) 坏账准备(续)

(ii) 于 2025 年 12 月 31 日，按组合计提坏账准备的应收账款汇总分析如下：

	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期 预期信用损失率	金额
一年以内	1,762,987,683.18	2.78%	(48,940,221.73)
一到二年	379,013,315.71	3.94%	(14,923,592.65)
二到三年	71,821,361.68	15.64%	(11,233,466.24)
三到四年	12,723,598.37	17.97%	(2,286,756.16)
四年以上	2,215,079.44	100.00%	(2,215,079.44)
	<u>2,228,761,038.38</u>		<u>(79,599,116.22)</u>

(iii) 于 2025 年度，本备考主体计提的坏账准备金额为 59,292,272.06 元，无转回的坏账准备金额，收回的坏账准备金额为 30,126,357.62 元。

(e) 于 2025 年度，本备考主体无核销的应收账款及坏账准备。

(f) 于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体无质押的应收账款。

(5) 预付款项

(a) 预付款项账龄分析如下：

	2025 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例
一年以内	68,198,305.42	98.97%
一到二年	51,906.22	0.08%
二到三年	655,517.20	0.95%
	<u>68,905,728.84</u>	<u>100.00%</u>

(b) 于 2025 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	<u>22,270,464.58</u>	<u>32.32%</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(6) 其他应收款

2025 年 12 月 31 日

应收投资款	73,717,070.00
保证金及押金	9,880,249.44
员工备用金	2,765,052.30
应收退税款	2,305,436.89
其他	5,095,086.62
	<u>93,762,895.25</u>
减：坏账准备	<u>(2,134,869.23)</u>
	<u>91,628,026.02</u>

本备考主体不存在因资金集中管理而将款项归集于其他方并列报于其他应收款的情况。

(a) 其他应收款账龄分析如下：

2025 年 12 月 31 日

一年以内	88,018,381.12
一到二年	1,047,311.39
二到三年	543,000.01
三年以上	4,154,202.73
	<u>93,762,895.25</u>

(b) 损失准备及其账面余额变动表

(i) 于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体无单项计提坏账准备的其他应收款。

(ii) 于 2025 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款分析如下：

	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额 金额	坏账准备 金额	计提比例
第一阶段—			
保证金及押金组合：	9,880,249.44	(869,494.57)	8.80%
其他：	83,504,469.73	(887,198.58)	1.06%
	<u>93,384,719.17</u>	<u>(1,756,693.15)</u>	
第三阶段—			
其他：	<u>378,176.08</u>	<u>(378,176.08)</u>	100.00%

于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体不存在处于第二阶段的其他应收款。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(6) 其他应收款(续)

(c) 于 2025 年度，本备考主体计提坏账准备金额为 1,063,636.44 元，收回的坏账准备金额为 16,148.35 元，转回的坏账准备金额为 150,961.20 元。

(d) 于 2025 年度，本备考主体无核销的其他应收款。

(e) 于 2025 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

	性质	余额	账龄	占其他应收款 余额总额比例	坏账准备
子公司员工持 股平台	投资款	37,067,070.00	一年以内	39.53%	(392,910.94)
关键管理人员	投资款	31,430,000.00	一年以内	33.52%	(333,158.00)
员工跟投平台	投资款	5,220,000.00	一年以内	5.57%	(55,332.00)
中国建筑第三 工程局有限 公司	投标保证金	3,500,000.00	三年以上	3.73%	(369,600.00)
公司 3	应收租金	2,255,726.73	一年以内	2.41%	(23,910.70)
		<u>79,472,796.73</u>		<u>84.76%</u>	<u>(1,174,911.64)</u>

(f) 于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体无按照应收金额确认的政府补助。

(g) 于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体均不存在逾期的应收股利。

(7) 存货

(a) 存货分类如下：

	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	2,843,823,792.68	(274,456,355.12)	2,569,367,437.56
在产品	909,847,730.69	(13,697,969.02)	896,149,761.67
发出商品	3,792,252,141.63	(959,266.86)	3,791,292,874.77
产成品	486,540,955.25	(6,531,368.93)	480,009,586.32
	<u>8,032,464,620.25</u>	<u>(295,644,959.93)</u>	<u>7,736,819,660.32</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(7) 存货(续)

(b) 存货跌价准备情况如下：

	2024 年 12 月 31 日	本年变动				2025 年 12 月 31 日
		计提	转回	转销或核销	外币报表折算	
原材料	220,586,990.57	68,233,148.92	(5,358.27)	(14,233,352.38)	(125,073.72)	274,456,355.12
在产品	8,682,614.14	12,197,551.71	-	(7,182,196.83)	-	13,697,969.02
发出商品	22,843,760.42	-	-	(21,884,493.56)	-	959,266.86
产成品	6,496,278.68	35,090.25	-	-	-	6,531,368.93
	<u>258,609,643.81</u>	<u>80,465,790.88</u>	<u>(5,358.27)</u>	<u>(43,300,042.77)</u>	<u>(125,073.72)</u>	<u>295,644,959.93</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(7) 存货(续)

(c) 存货跌价准备情况如下：

	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	以所生产的产成品的预计售价，减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用、合同履约成本和相关税费后的金额。	以前减记存货价值的影响因素已经消失。
在产品	以所生产的产成品的预计售价，减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用、合同履约成本和相关税费后的金额。	以前减记存货价值的影响因素已经消失。
发出商品	发出商品的预计售价，减去估计的销售费用、合同履约成本和相关税费后的金额。	以前减记存货价值的影响因素已经消失。
产成品	产成品的预计售价，减去估计的销售费用、合同履约成本和相关税费后的金额。	以前减记存货价值的影响因素已经消失。

(8) 合同资产

2025 年 12 月 31 日

合同资产	16,160,974.15
减：合同资产减值准备	(544,125.53)
	<u>15,616,848.62</u>

(i) 于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体无单项计提准备的合同资产。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(8) 合同资产(续)

(ii) 于 2025 年 12 月 31 日，按组合计提减值准备的合同资产分析如下：

	账面余额	2025 年 12 月 31 日	
		坏账准备	
	金额	整个存续期 预期信用损失率	金额
一年以内	13,577,021.74	3.37%	(457,126.17)
一到两年	2,583,952.41	3.37%	(86,999.36)
	<u>16,160,974.15</u>	<u>3.37%</u>	<u>(544,125.53)</u>

(iii) 于 2025 年度，本备考主体计提的减值准备金额为 479,218.07 元，转回的减值准备金额为 661,028.48 元。收回的减值准备金额为 97,929.62 元。

本备考主体对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2025 年度本备考主体不存在重要的合同资产的核销情况。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(9) 其他流动资产

2025 年 12 月 31 日

待抵扣进项税额	856,282,855.99
预缴所得税	<u>26,153,152.02</u>
	<u>882,436,008.01</u>

(10) 长期应收款

2025 年 12 月 31 日

其他押金及保证金	13,242,573.54
减：长期应收款坏账准备	<u>(1,000,484.18)</u>
	<u>12,242,089.36</u>

于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体的长期应收款主要处于第一阶段。

(11) 长期股权投资

2025 年 12 月 31 日

联营企业	1,473,789,351.74
减：长期股权投资减值准备	<u>(29,018,933.23)</u>
	<u>1,444,770,418.51</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(11) 长期股权投资(续)

	本年增减变动							减值准备		
	2024 年 12 月 31 日	新增投资	按权益法调整 的净损益	发放现金股利	计提减值准备	其他权益变动	其他综合收益调整	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
联营企业 1	410,378,105.38	-	65,011,782.62	(5,539,402.35)	-	32,135,176.73	-	501,985,662.38	-	-
联营企业 2	358,250,029.36	-	(8,646,048.09)	-	-	-	-	349,603,981.27	-	-
联营企业 3	43,576,211.77	-	2,594,011.61	-	-	(2,232,892.47)	-	43,937,330.91	-	-
联营企业 4	19,537,529.25	-	(1,487,750.24)	-	(18,049,779.01)	-	-	-	(18,049,779.01)	-
上海智微攀峰创业投资合伙企业(有限合伙)	-	514,500,000.00	3,829,127.09	-	-	-	-	518,329,127.09	-	-
上海芯元基半导体科技有限公司	12,967,911.97	-	(319,098.15)	-	-	1,286,097.11	-	13,934,910.93	-	-
南昌城微置业有限公司	9,618,457.50	-	(326,167.54)	-	-	-	-	9,292,289.96	-	-
SOLAYER GmbH ("Solayer")	11,073,093.19	-	(4,234,085.75)	-	-	-	(3,302,101.00)	3,536,906.44	(10,969,154.22)	(10,969,154.22)
拓朴微(上海)技术有限公司	4,192,152.04	-	(1,584,840.26)	-	-	-	-	2,607,311.78	-	-
上海智微私募基金管理有限公司	-	4,500,000.00	(2,957,102.25)	-	-	-	-	1,542,897.75	-	-
	<u>869,593,490.46</u>	<u>519,000,000.00</u>	<u>51,879,829.04</u>	<u>(5,539,402.35)</u>	<u>(18,049,779.01)</u>	<u>31,188,381.37</u>	<u>(3,302,101.00)</u>	<u>1,444,770,418.51</u>	<u>(29,018,933.23)</u>	<u>(10,969,154.22)</u>

(i) 于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体存在公开报价的联营企业投资的公允价值为人民币 6,770,380,531.20 元。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(12) 其他非流动金融资产

2025 年 12 月 31 日

权益工具投资

1,894,270,431.23

(13) 投资性房地产

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	2025 年 12 月 31 日
房屋及建筑物 —			
原值	8,705,124.84	-	8,705,124.84
累计折旧	<u>(2,911,682.91)</u>	<u>(413,493.42)</u>	<u>(3,325,176.33)</u>
账面价值	<u>5,793,441.93</u>	<u>(413,493.42)</u>	<u>5,379,948.51</u>

于 2025 年度，投资性房地产摊销计入当期损益的金额为 413,493.42 元。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(14) 固定资产

	房屋及建筑物	机器设备	计算机及电子设备	办公设备	运输工具	合计
原值						
2024 年 12 月 31 日	2,496,538,909.37	166,369,619.36	566,123,183.64	24,492,477.29	6,819,886.42	3,260,344,076.08
在建工程转入	120,277,370.00	6,151,933.88	85,133,344.69	178,756.16	-	211,741,404.73
本年其他增加	2,397,899.11	128,469,780.54	14,567,897.03	207,514.16	25,663.72	145,668,754.56
本年其他减少	-	(7,358,658.08)	(6,102,603.31)	-	(533,806.70)	(13,995,068.09)
政府补助	-	(51,012,344.33)	(9,619,569.98)	-	-	(60,631,914.31)
外币报表折算差异	-	(1,090,575.11)	(1,305,348.70)	(13,895.41)	(4,704.70)	(2,414,523.92)
2025 年 12 月 31 日	<u>2,619,214,178.48</u>	<u>241,529,756.26</u>	<u>648,796,903.37</u>	<u>24,864,852.20</u>	<u>6,307,038.74</u>	<u>3,540,712,729.05</u>
累计折旧						
2024 年 12 月 31 日	(157,297,985.50)	(72,879,321.65)	(268,917,313.64)	(19,864,662.07)	(2,981,962.97)	(521,941,245.83)
本年计提	(70,251,724.47)	(25,572,535.50)	(83,380,502.29)	(3,067,472.43)	(1,013,531.75)	(183,285,766.44)
本年减少	-	7,320,150.45	3,452,006.03	-	507,116.37	11,279,272.85
外币报表折算差异	-	181,313.26	278,628.99	11,493.37	1,862.28	473,297.90
2025 年 12 月 31 日	<u>(227,549,709.97)</u>	<u>(90,950,393.44)</u>	<u>(348,567,180.91)</u>	<u>(22,920,641.13)</u>	<u>(3,486,516.07)</u>	<u>(693,474,441.52)</u>
减值准备						
2024 年 12 月 31 日	-	(98,958.18)	-	-	-	(98,958.18)
2025 年 12 月 31 日	-	(98,958.18)	-	-	-	(98,958.18)
账面价值						
2025 年 12 月 31 日	<u>2,391,664,468.51</u>	<u>150,480,404.64</u>	<u>300,229,722.46</u>	<u>1,944,211.07</u>	<u>2,820,522.67</u>	<u>2,847,139,329.35</u>
2024 年 12 月 31 日	<u>2,339,240,923.87</u>	<u>93,391,339.53</u>	<u>297,205,870.00</u>	<u>4,627,815.22</u>	<u>3,837,923.45</u>	<u>2,738,303,872.07</u>

- (i) 2025 年度计入营业成本、销售费用、管理费用、研发费用及开发支出的折旧费用为 78,028,646.28 元、3,517,004.34 元、25,073,491.05 元、52,008,280.46 元及 24,658,344.31 元。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(14) 固定资产(续)

(ii) 于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体不存在未办妥产权证书的固定资产。

(15) 在建工程

	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
临港总部及研发中心项目	597,901,583.35	-	597,901,583.35
大平板设备洁净室改造工程	131,762,160.93	-	131,762,160.93
临港产业化基地一期项目	22,717,870.34	-	22,717,870.34
临港洁净室改造工程	12,347,732.90	-	12,347,732.90
其他	98,145,133.87	-	98,145,133.87
	<u>862,874,481.39</u>	<u>-</u>	<u>862,874,481.39</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(15) 在建工程(续)

重大在建工程项目变动

工程名称	预算数	2024 年 12 月 31 日	本年增加	转入固定资产	2025 年 12 月 31 日	工程投入 占预算的比例	工程进度	资金来源
临港产业化基地一期项目(i)	140,000 万	21,460,734.86	121,789,029.34	(120,531,893.86)	22,717,870.34	95.74%	95.74%	自有资金/募集资金/政府补助资金
临港总部及研发中心项目	108,000 万	459,540,593.07	138,360,990.28	-	597,901,583.35	64.09%	64.09%	自有资金/募集资金
大平板设备洁净室改造工程	14,144 万	104,387,754.05	27,374,406.88	-	131,762,160.93	93.16%	93.16%	自有资金/政府补助资金
		<u>585,389,081.98</u>	<u>287,524,426.50</u>	<u>(120,531,893.86)</u>	<u>752,381,614.62</u>			

(i) 本备考主体自建的临港产业化基地一期项目部分厂房于 2025 年度完成验收并达到预定可使用状态，相应转入固定资产。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(16) 使用权资产

	房屋及建筑物	办公设备	合计
原价			
2024 年 12 月 31 日	55,409,543.93	23,296.97	55,432,840.90
本年新增租赁合同	3,301,716.02	-	3,301,716.02
本年结束租赁合同	(12,931,012.74)	(30,345.52)	(12,961,358.26)
外币报表折算差异	2,512,850.62	7,048.55	2,519,899.17
2025 年 12 月 31 日	<u>48,293,097.83</u>	<u>-</u>	<u>48,293,097.83</u>
累计折旧			
2024 年 12 月 31 日	(24,608,500.00)	(22,152.56)	(24,630,652.56)
本年计提	(10,877,328.81)	-	(10,877,328.81)
本年结束租赁合同	7,039,360.10	30,345.52	7,069,705.62
外币报表折算差异	917,618.18	(8,192.96)	909,425.22
2025 年 12 月 31 日	<u>(27,528,850.53)</u>	<u>-</u>	<u>(27,528,850.53)</u>
账面价值			
2025 年 12 月 31 日	<u>20,764,247.30</u>	<u>-</u>	<u>20,764,247.30</u>
2024 年 12 月 31 日	<u>30,801,043.93</u>	<u>1,144.41</u>	<u>30,802,188.34</u>

2025 年度计入营业成本、销售费用、管理费用和研发费用的折旧费用分别为 1,926,396.70 元、6,089,223.51 元、2,245,601.73 元和 616,106.87 元。

(17) 无形资产

	土地使用权	软件	专有技术权	内部开发技术	合计
原价					
2024 年 12 月 31 日	198,901,232.11	68,216,049.59	375,302,334.33	906,707,782.21	1,549,127,398.24
本年购入	73,754,316.04	6,734,247.45	-	-	80,488,563.49
开发支出转入	-	-	-	702,477,532.60	702,477,532.60
外币报表折算差异	(98,684.53)	(326.11)	-	-	(99,010.64)
2025 年 12 月 31 日	<u>272,556,863.62</u>	<u>74,949,970.93</u>	<u>375,302,334.33</u>	<u>1,609,185,314.81</u>	<u>2,331,994,483.69</u>
累计摊销					
2024 年 12 月 31 日	(17,903,267.59)	(52,884,952.60)	(56,539,700.00)	(409,400,270.38)	(536,728,190.57)
本年计提	(4,940,389.82)	(10,476,452.27)	(31,876,263.43)	(175,052,949.30)	(222,346,054.82)
外币报表折算差异	98,684.53	326.11	-	-	99,010.64
2025 年 12 月 31 日	<u>(22,744,972.88)</u>	<u>(63,361,078.76)</u>	<u>(88,415,963.43)</u>	<u>(584,453,219.68)</u>	<u>(758,975,234.75)</u>
账面价值					
2025 年 12 月 31 日	<u>249,811,890.74</u>	<u>11,588,892.17</u>	<u>286,886,370.90</u>	<u>1,024,732,095.13</u>	<u>1,573,019,248.94</u>
2024 年 12 月 31 日	<u>180,997,964.52</u>	<u>15,331,096.99</u>	<u>318,762,634.33</u>	<u>497,307,511.83</u>	<u>1,012,399,207.67</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(17) 无形资产(续)

(a) 2025 年度计入在建工程、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用及开发支出的摊销费用为 1,372,994.89 元、207,769,566.21 元、98,068.99 元、4,708,537.37 元、7,651,828.32 元及 745,059.04 元。

(b) 于 2025 年 12 月 31 日，通过本备考主体内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 65.14%。

(18) 研究开发支出

本备考主体 2025 年度研究开发活动的总支出按性质列示如下：

	研发费用	开发支出	合计
耗用的原材料和低值易耗品等	1,282,615,143.84	512,394,228.66	1,795,009,372.50
职工薪酬费用(含股份支付)	1,052,670,326.48	360,686,996.10	1,413,357,322.58
测试维护费用	147,674,114.68	59,263,176.92	206,937,291.60
折旧与摊销费用	60,185,605.13	25,403,403.35	85,589,008.48
交通差旅费用	16,710,984.32	15,604,057.75	32,315,042.07
水电费用	13,662,062.12	10,009,402.16	23,671,464.28
办公费用	5,530,595.80	3,867,880.06	9,398,475.86
其他	10,556,096.32	2,720,087.70	13,276,184.02
	<u>2,589,604,928.69</u>	<u>989,949,232.70</u>	<u>3,579,554,161.39</u>

于 2025 年度，本备考主体收到政府补助冲减研发支出的金额为 269,403,280.66 元。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(18) 研究开发支出(续)

(a) 本备考主体 2025 年度符合资本化条件的开发支出的变动分析如下：

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年转入 无形资产	2025 年 12 月 31 日
刻蚀机相关项目	765,357,209.05	558,384,182.59	(636,461,285.64)	687,280,106.00
化学气相沉积项目	416,332,502.29	391,502,308.23	-	807,834,810.52
MOCVD 相关项目	65,899,273.68	40,062,741.88	(66,016,246.96)	39,945,768.60
	<u>1,247,588,985.02</u>	<u>989,949,232.70</u>	<u>(702,477,532.60)</u>	<u>1,535,060,685.12</u>

(i) 本公司研究开发项目资本化开始时点为试制机技术测试基本完成，试制机机台基础技术性能符合设计规格要求并取得相关测试报告。

2025 年度，本备考主体开发支出项目不存在减值情况。

(19) 商誉

	2025 年 12 月 31 日
商誉(附注二)	959,227,068.86
减：减值准备	-
	<u>959,227,068.86</u>

(20) 长期待摊费用

	使用权资产改良
2024 年 12 月 31 日	9,084,409.07
本年增加	187,614.63
本年摊销	(2,752,501.57)
外币报表折算差异	(108,578.31)
2025 年 12 月 31 日	<u>6,410,943.82</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(21) 递延所得税资产和递延所得税负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

	2025 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异 及可抵扣亏损	递延所得税资产
股份支付	1,546,761,585.19	232,014,237.78
可抵扣亏损	563,512,075.96	84,522,474.27
资产减值准备	395,469,801.99	59,320,165.24
递延收益	220,697,814.14	33,104,672.12
预提费用	205,695,564.33	30,854,334.65
租赁负债	20,429,207.99	3,165,825.46
其他	390,347,919.41	58,552,187.91
	<u>3,342,913,969.01</u>	<u>501,533,897.43</u>
其中：		
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		256,318,002.54
预计于 1 年后转回的金额		<u>245,215,894.89</u>
		<u>501,533,897.43</u>

(b) 未经抵销的递延所得税负债

	2025 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产的公允价值变动	(772,197,206.21)	(115,871,841.20)
非同一控制下企业合并形成的被合 并方可辨认净资产公允价值与账 面价值的差额	(317,384,714.39)	(47,607,707.16)
使用权资产	(20,764,247.30)	(3,211,439.18)
	<u>(1,110,346,167.90)</u>	<u>(166,690,987.54)</u>
其中：		
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		(15,267,114.53)
预计于 1 年后转回的金额		<u>(151,423,873.01)</u>
		<u>(166,690,987.54)</u>

(c) 本备考主体未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下：

	2025 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	227,210,774.78
可抵扣亏损	2,711,707,112.89
	<u>2,938,917,887.67</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(21) 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

(d) 本公司及子公司未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

2025 年 12 月 31 日

2026	21,563,311.72
2027	30,455,306.96
2028	96,003,692.00
2029	170,567,523.39
2030	1,031,065,112.28
2031	54,318,912.98
2032	92,989,159.55
2033	105,563,930.60
2034	211,625,809.90
2035	194,232,718.81
无固定到期日	703,321,634.70
	<u>2,711,707,112.89</u>

(e) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

2025 年 12 月 31 日

	互抵金额	抵销后余额
递延所得税资产	(166,585,336.86)	334,948,560.57
递延所得税负债	166,585,336.86	<u>(105,650.68)</u>

(22) 其他非流动资产

2025 年 12 月 31 日

预付投资款	200,000,000.00
预付长期资产购置款	124,620,532.75
预付公租房认购款	91,190,057.40
大额存单及利息	30,596,712.33
	<u>446,407,302.48</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(23) 资产减值及损失准备

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		外币报表折算差异	2025 年 12 月 31 日
			收回或转回	转销或核销		
应收账款坏账准备	50,308,991.20	59,292,272.06	(30,126,357.62)	-	124,210.58	79,599,116.22
其中：组合计提坏账准备	50,308,991.20	59,292,272.06	(30,126,357.62)	-	124,210.58	79,599,116.22
应收票据坏账准备	935,499.51	610,971.00	(935,499.51)	-	-	610,971.00
其他应收款坏账准备	1,239,219.22	1,063,636.44	(167,109.55)	-	(876.88)	2,134,869.23
长期应收款坏账准备	1,005,498.44	-	(542.84)	-	(4,471.42)	1,000,484.18
小计	<u>53,489,208.37</u>	<u>60,966,879.50</u>	<u>(31,229,509.52)</u>	<u>-</u>	<u>118,862.28</u>	<u>83,345,440.63</u>
存货跌价准备	258,609,643.81	80,465,790.88	(5,358.27)	(43,300,042.77)	(125,073.72)	295,644,959.93
合同资产减值准备	823,865.56	479,218.07	(758,958.10)	-	-	544,125.53
长期股权投资减值准备	10,969,154.22	18,049,779.01	-	-	-	29,018,933.23
固定资产减值准备	98,958.18	-	-	-	-	98,958.18
小计	<u>270,501,621.77</u>	<u>98,994,787.96</u>	<u>(764,316.37)</u>	<u>(43,300,042.77)</u>	<u>(125,073.72)</u>	<u>325,306,976.87</u>
	<u>323,990,830.14</u>	<u>159,961,667.46</u>	<u>(31,993,825.89)</u>	<u>(43,300,042.77)</u>	<u>(6,211.44)</u>	<u>408,652,417.50</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(24) 短期借款

2025 年 12 月 31 日

保证借款	140,110,890.56
信用借款	10,008,438.36
	<u>150,119,328.92</u>

(a) 于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体的短期借款包括：

于 2025 年 1 月 7 日，本备考主体从中信银行股份有限公司杭州分行取得保证借款人民币 9,000,000.00 元，借款到期日为 2026 年 1 月 7 日，年利率为 3.01%，按季度付息。由杭州众硅之实际控制人 GU HAIYANG、监事 ZHU SHAN 提供担保。

于 2025 年 1 月 10 日，本备考主体从中信银行股份有限公司杭州分行取得保证借款人民币 5,000,000.00 元，借款到期日为 2026 年 1 月 10 日，年利率为 3.01%，按季度付息，系由杭州众硅之实际控制人 GU HAIYANG 提供担保。

于 2025 年 1 月 17 日，本备考主体从中信银行股份有限公司杭州分行取得保证借款人民币 6,000,000.00 元，借款到期日为 2026 年 1 月 17 日，年利率为 3.01%，按季度付息，系由杭州众硅之实际控制人 GU HAIYANG 提供担保。

于 2025 年 6 月 5 日，本备考主体从杭州银行股份有限公司海创园支行取得保证借款人民币 20,000,000.00 元，借款到期日为 2026 年 6 月 4 日，年利率为 2.80%，按季度付息，系由杭州众硅之实际控制人 GU HAIYANG 提供担保。

于 2025 年 8 月 4 日，本备考主体从杭州银行股份有限公司海创园支行取得保证借款人民币 30,000,000.00 元，借款到期日为 2026 年 8 月 3 日，年利率为 2.60%，按季度付息，系由杭州众硅之实际控制人 GU HAIYANG 提供担保。

于 2025 年 8 月 13 日，本备考主体从宁波银行股份有限公司杭州分行取得信用借款人民币 10,000,000.00 元，借款到期日为 2026 年 8 月 12 日，年利率为 2.80%，按月付息。

于 2025 年 9 月 19 日，本备考主体从中信银行股份有限公司杭州分行取得保证借款人民币 30,000,000.00 元，借款到期日为 2026 年 3 月 20 日，年利率为 2.70%，按季度付息，系由杭州众硅之实际控制人 GU HAIYANG 提供担保。

于 2025 年 12 月 24 日，本备考主体从招商银行股份有限公司杭州分行取得保证借款人民币 30,000,000.00 元，借款到期日为 2026 年 6 月 24 日，年利率为 2.70%，按月付息，系由杭州众硅之实际控制人 GU HAIYANG 提供担保。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(24) 短期借款(续)

- (a) 于 2025 年 12 月 26 日，本备考主体从江苏银行股份有限公司杭州分行取得保证借款人民币 10,000,000.00 元，借款到期日为 2026 年 12 月 25 日，年利率为 2.80%，按月付息，系由杭州众硅之实际控制人 GU HAIYANG、监事 ZHU SHAN 提供担保。

于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体不存在逾期短期借款，利率区间为 2.60%至 3.01%。

(25) 应付账款

2025 年 12 月 31 日

应付材料采购款

1,903,740,001.92

- (a) 于 2025 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款 6,684,869.59 元，主要为未结清的应付材料采购款。

(26) 合同负债

2025 年 12 月 31 日

预收产品销售款

3,064,215,948.28

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(27) 应付职工薪酬

2025 年 12 月 31 日

应付短期薪酬(a)	467,729,660.19
应付设定提存计划(b)	751,957.25
应付辞退福利(c)	-
	<u>468,481,617.44</u>

(a) 短期薪酬

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2025 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴 和补贴	376,663,594.22	1,907,621,699.18	(1,851,160,883.18)	433,124,410.22
职工福利费	29,346,881.64	88,962,635.63	(84,160,784.81)	34,148,732.46
社会保险费	480,105.15	63,975,664.36	(64,014,404.00)	441,365.51
其中：医疗保险费	452,158.31	61,807,804.60	(61,827,726.96)	432,235.95
工伤保险费	27,946.84	2,006,208.15	(2,025,025.43)	9,129.56
生育保险费	-	161,651.61	(161,651.61)	-
住房公积金	21,657.00	58,170,643.99	(58,177,148.99)	15,152.00
股票增值权	-	-	-	-
	<u>406,512,238.01</u>	<u>2,118,730,643.16</u>	<u>(2,057,513,220.98)</u>	<u>467,729,660.19</u>

(b) 设定提存计划

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2025 年 12 月 31 日
基本养老保险	716,608.80	112,567,410.82	(112,554,849.29)	729,170.33
失业保险费	23,837.37	3,675,569.98	(3,676,620.43)	22,786.92
	<u>740,446.17</u>	<u>116,242,980.80</u>	<u>(116,231,469.72)</u>	<u>751,957.25</u>

(c) 应付辞退福利

于 2025 年度，本备考主体因解除劳动关系所支付的辞退福利为 9,427,535.97 元。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(28) 应交税费

2025 年 12 月 31 日

应交企业所得税	67,894,607.11
代扣代缴的个人所得税	12,661,840.34
应交增值税	8,499,273.04
应交房产税	3,378,159.93
应交印花税	3,329,974.67
应交城市维护建设税	1,738,049.94
其他	5,614,322.79
	<u>103,116,227.82</u>

(29) 其他应付款

2025 年 12 月 31 日

应付采购工程及固定资产款	310,684,337.60
应付日常运营费用	195,610,789.51
应付增资款	52,585,310.41
应付专业机构服务费	8,534,969.27
应付物流费	7,180,132.92
政府补助	4,000,000.00
其他	8,303,130.85
	<u>586,898,670.56</u>

于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体无账龄超过一年的重要其他应付款。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(30) 一年内到期的非流动负债

2025 年 12 月 31 日

一年内到期的租赁负债

(附注五(33))

12,729,903.92

一年内到期的长期借款及利息

10,293,160.00

23,023,063.92

(31) 其他流动负债

2025 年 12 月 31 日

产品质量质保金(附注五(34))

209,457,805.11

待转销项税额

2,656,870.59

212,114,675.70

(32) 长期借款

2025 年 12 月 31 日

信用借款

739,800,000.00

减：预计将于一年内偿还部分

(9,400,000.00)

730,400,000.00

于 2024 年 6 月 14 日，本备考主体从中国农业银行上海自贸试验区新片区分行取得借款人民币 250,000,000.00 元，年利率为 2.25%，按季度付息，借款合同到期日为 2027 年 6 月 13 日。截止 2025 年 12 月 31 日，本备考主体已偿还本金 3,000,000.00 元。于 2026 年度到期的借款本金为 2,000,000.00 元，剩余 245,000,000.00 元借款本金于 2027 年度到期。于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体将于 2026 年度到期的借款本金 2,000,000.00 元列示为“一年内到期的非流动负债”。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(32) 长期借款(续)

于 2024 年 11 月 14 日，本备考主体从中国建设银行股份有限公司上海浦东分行取得借款人民币 50,000,000.00 元，年利率为 2.35%，按季度付息，借款合同到期日为 2027 年 11 月 12 日。截至 2025 年 12 月 31 日，本备考主体已偿还本金 200,000.00 元，于 2026 年度到期的借款本金为 400,000.00 元，剩余 49,400,000.00 元借款本金于 2027 年度到期。于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体将于 2026 年度到期的借款本金 400,000.00 元列示为“一年内到期的非流动负债”。

于 2024 年 11 月 13 日，本备考主体从平安银行股份有限公司上海分行取得借款人民币 200,000,000.00 元，年利率为 2.45%，按季度付息，借款合同到期日为 2027 年 11 月 13 日。截至 2025 年 12 月 31 日，本备考主体已偿还本金 2,000,000.00 元，于 2026 年度到期的借款本金为 2,000,000.00 元，剩余 196,000,000.00 元借款本金于 2027 年度到期。于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体将于 2026 年度到期的借款本金 2,000,000.00 元列示为“一年内到期的非流动负债”。

于 2024 年 12 月 5 日，本备考主体从招商银行股份有限公司上海分行营业部取得借款人民币 250,000,000.00 元，年利率为 2.35%，按季度付息。截止 2025 年 12 月 31 日，本备考主体已偿还 5,000,000.00 元。于 2026 年度到期的借款本金为 5,000,000.00 元，剩余 240,000,000.00 元借款本金到期日为 2027 年 12 月 5 日。于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体将于 2026 年度到期的借款本金 5,000,000.00 元列示为“一年内到期的非流动负债”。

于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体不存在逾期长期借款。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(33) 租赁负债

2024 年 12 月 31 日

租赁负债	24,536,795.64
减：一年内到期的非流动负债 (附注五(30))	<u>(12,729,903.92)</u>
	<u>11,806,891.72</u>

(a) 于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体简化处理的短期租赁合同的未来最低应支付租金为 393,120.64 元，均为一年内支付。

(b) 于 2025 年 12 月 31 日，本备考主体无已签订但尚未开始执行的租赁合同。

(34) 预计负债

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2025 年 12 月 31 日
产品质量保证金	<u>175,164,282.48</u>	<u>538,686,520.55</u>	<u>(494,128,244.88)</u>	<u>219,722,558.15</u>
减：预计将于一年 内到期部分	<u>(158,891,384.00)</u>			<u>(209,457,805.11)</u>
	<u>16,272,898.48</u>			<u>10,264,753.04</u>

(i) 本备考主体将预计将于一年内到期部分预计负债列示于其他流动负债科目。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(35) 递延收益

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2025 年 12 月 31 日		
政府补助	<u>95,736,672.93</u>	<u>400,888,800.00</u>	<u>(326,815,194.97)</u>	<u>169,810,277.96</u>		
	2024 年 12 月 31 日	本年 增加	冲减固定资产 及无形资产	冲减 研发支出	其他变动	2025 年 12 月 31 日
与资产相关的政府补助(i)	-	61,111,914.31	(61,111,914.31)	-	-	-
与收益相关的政府补助	<u>95,736,672.93</u>	<u>339,776,885.69</u>	<u>-</u>	<u>(265,703,280.66)</u>	<u>-</u>	<u>169,810,277.96</u>
	<u>95,736,672.93</u>	<u>400,888,800.00</u>	<u>(61,111,914.31)</u>	<u>(265,703,280.66)</u>	<u>-</u>	<u>169,810,277.96</u>

- (i) 本备考主体将收到的研发项目补贴 60,631,914.31 元和 480,000.00 元直接冲减固定资产和无形资产的账面价值，2025 年度相应减少的折旧费用和摊销费用为 8,930,264.67 元和 53,333.33 元。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(36) 其他非流动负债

2025 年 12 月 31 日

政府补助	3,340,000.00
剩余基金财产分配义务	1,648,385.00
	<u>4,988,385.00</u>

(37) 归属于母公司股东权益

2025 年 12 月 31 日

年初母公司股东权益	21,278,873,193.07
加：净利润	1,987,975,583.08
股份支付费用计入所有者权益(附注十一(1))	525,231,428.80
股份支付行权导致的权益变动	236,695,696.70
出售库存股导致的权益变动	153,867,354.07
股份支付产生的递延所得税计入所有者权益	94,958,658.42
联营企业被投资单位其他所有者权益变动(附注五(11))	15,840,748.17
被动稀释导致的权益变动	15,347,633.20
其他综合收益	4,757,811.69
减：支付普通股股利(a)	<u>(187,214,710.20)</u>
年末母公司股东权益	<u>24,126,333,397.00</u>

- (a) 根据 2025 年 5 月 28 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.3 元，按照于 2025 年 7 月 9 日本公司已发行股份 624,049,034 股计算，共计 187,214,710.20 元。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(38) 营业收入和营业成本

	2025 年度
主营业务收入	<u>12,628,757,057.36</u>
	2025 年度
主营业务成本	<u>7,746,897,056.31</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2025 年度	
	主营业务收入	主营业务成本
销售专用设备	10,766,765,867.04	6,737,638,944.66
销售备品备件	1,754,189,036.12	959,148,125.23
其他收入	107,802,154.20	50,109,986.42
	<u>12,628,757,057.36</u>	<u>7,746,897,056.31</u>

(b) 本备考主体按报告分部与产品及服务转让时间分解的营业收入及营业成本信息列示如下：

	2025 年度			
	销售专用设备	销售备品备件	其他收入	合计
主营业务收入				
其中：在某一时点确认	10,766,765,867.04	1,754,189,036.12	77,678,398.63	12,598,633,301.79
在某一时段内确认	-	-	30,123,755.57	30,123,755.57
	<u>10,766,765,867.04</u>	<u>1,754,189,036.12</u>	<u>107,802,154.20</u>	<u>12,628,757,057.36</u>
	2025 年度			
	销售专用设备	销售备品备件	其他收入	合计
主营业务成本				
其中：相关收入在某一时点确认	6,737,638,944.66	959,148,125.23	36,185,585.09	7,732,972,654.98
相关收入在某一时段内确认	-	-	13,924,401.33	13,924,401.33
	<u>6,737,638,944.66</u>	<u>959,148,125.23</u>	<u>50,109,986.42</u>	<u>7,746,897,056.31</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(38) 营业收入和营业成本(续)

(c) 于 2025 年度，本备考主体自客户 1 取得的营业收入占本备考主体营业收入的比重超过 10%，金额为 4,877,478,568.64 元，占本备考主体营业收入的 38.62%。

(d) 于 2025 年度，本备考主体主要在中国境内销售商品和提供劳务，本备考主体资产主要位于中国境内。

(39) 税金及附加

2025 年度

城市维护建设税	19,942,619.56
房产税	19,173,790.70
印花税	14,383,586.90
教育费附加	8,622,944.73
其他	6,392,873.84
	<u>68,515,815.73</u>

(40) 销售费用

2025 年度

职工薪酬费用	334,431,879.44
股份支付费用	103,326,613.85
交通差旅费用	16,771,186.62
折旧与摊销费用	11,614,810.41
办公费用	8,944,998.50
水电费用	4,143,677.73
其他	24,405,412.90
	<u>503,638,579.45</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(41) 管理费用

2025 年度

职工薪酬费用	268,175,825.53
股份支付费用	117,684,486.55
折旧与摊销费用	32,625,426.41
专业机构服务费用	30,623,151.18
招聘费用	17,278,395.26
专利费用	16,851,075.72
保险费用	7,846,050.28
办公费用	7,176,857.68
交通差旅费用	6,992,820.34
水电费用	6,029,430.76
会务费用	3,714,390.36
耗用的原材料和低值易耗品等	1,887,128.72
其他	9,747,838.33
	<u>526,632,877.12</u>

(42) 研发费用

2025 年度

耗用的原材料和低值易耗品等	1,282,615,143.84
职工薪酬费用	792,069,177.36
股份支付费用	260,601,149.12
测试维护费用	147,674,114.68
折旧与摊销费用	60,185,605.13
交通差旅费用	16,710,984.32
水电费用	13,662,062.12
办公费用	5,530,595.80
其他	10,556,096.32
	<u>2,589,604,928.69</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(43) 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

	2025 年度
产成品及在产品等存货变动	(417,774,118.41)
耗用的原材料和低值易耗品等	8,154,574,171.98
职工薪酬费用	1,675,705,244.60
预计产品质量保证	538,686,520.55
股份支付费用(a)	526,081,192.92
折旧与摊销费用	392,898,746.82
测试维护费用	153,476,733.26
水电费用	85,667,890.02
仓储物流费用	56,141,621.26
交通差旅费用	44,555,317.93
办公费用	41,684,904.66
专业机构服务费用	39,724,478.74
专利费用	17,266,360.45
其他	58,084,376.79
	<u>11,366,773,441.57</u>

(a) 股份支付费用

本备考主体 2025 年度股份支付费用包括：本公司历年授予的第二类限制性股票的股份支付费用；杭州众硅历年授予的第一类限制性股票的股份支付费用；以及由于本次重组交易本公司有义务替代杭州众硅原有股权激励计划，按评估基准日 2025 年 12 月 31 日重新计量股份支付的公允价值变动，计入企业合并后的股份支付费用。

(44) 公允价值变动收益

	2025 年度
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产— 权益工具投资	165,171,563.38
结构性存款及银行理财产品	(1,283,207.27)
其他非流动负债	(2,535,210.65)
	<u>161,353,145.46</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(45) 信用减值损失

2025 年度

应收账款坏账损失	29,165,914.44
其他应收款坏账损失	896,526.89
应收票据坏账转回	(324,528.51)
长期应收款坏账转回	(542.84)
	<u>29,737,369.98</u>

(46) 资产减值损失

2025 年度

存货跌价损失	80,460,432.61
长期股权投资减值损失	18,049,779.01
合同资产减值转回	(279,740.03)
	<u>98,230,471.59</u>

(47) 财务收入-净额

2025 年度

利息收入	102,494,516.74
减：利息费用	(23,724,464.76)
其中：租赁负债利息支出	(929,679.46)
汇兑净损失	(27,535,384.17)
手续费	(7,293,521.21)
	<u>43,941,146.60</u>

(48) 其他收益

2025 年度

财政补贴与扶持资金	239,302,822.18
先进制造业加计抵减税额	13,876,231.06
研发中心奖励	8,460,165.77
产业协调发展补助	3,625,000.00
其他	5,066,727.05
	<u>270,330,946.06</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(49) 投资收益

2025 年度

处置其他非流动金融资产产生的投资收益	442,158,660.21
按权益份额分担的被投资单位净收益	51,879,829.04
结构性存款及银行理财产品投资收益	16,575,955.58
其他非流动金融资产收益-被投资单位发放的现金股利	3,101,356.53
	<u>513,715,801.36</u>

(50) 资产处置收益

2025 年度

固定资产处置利得	<u>3,444,901.80</u>
----------	---------------------

于 2025 年度，资产处置收益均已计入非经常性损益。

(51) 营业外收入

2025 年度

公租房租赁收入	6,015,965.24
赔偿款	3,030,923.78
其他	502,456.00
	<u>9,549,345.02</u>

于 2025 年度，营业外收入均已计入非经常性损益。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(52) 营业外支出

	2025 年度
对外捐赠	9,007,574.53
其他	1,188,982.85
	<u>10,196,557.38</u>

于 2025 年度，营业外支出均已计入非经常性损益。

(53) 所得税费用

	2025 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	185,402,358.74
递延所得税	(59,770,293.72)
	<u>125,632,065.02</u>

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2025 年度
利润总额	<u>2,057,638,687.41</u>
按适用税率 25% 计算的所得税	514,409,671.85
子公司税率差异	(38,119,403.52)
优惠税率的影响	(221,453,806.62)
非应税收入	(8,304,992.93)
不得扣除的成本、费用和损失	8,945,725.37
安置残疾人员所支付的工资加计扣除	(208,968.81)
研发加计扣除	(307,429,680.21)
当期递延所得税资产的暂时性差异	30,171,734.36
与本公司所投资的合伙企业利润分配相关的递延所得税负债变动	(11,563,546.43)
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	159,185,331.96
	<u>125,632,065.02</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(54) 每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算:

	2025 年度
归属于本公司普通股股东的合并净利润	1,987,975,583.08
本公司发行在外普通股的加权平均数	631,740,277.00
基本每股收益	<u>3.15</u>
其中:	
— 持续经营基本每股收益:	3.15
— 终止经营基本每股收益:	-

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。

	2025 年度
归属于本公司普通股股东的合并净利润	1,987,975,583.08
本公司发行在外普通股的加权平均数	631,740,277.00
加: 由于授予限制性股票而增加的加权平均数	6,825,394.00
经调整的本公司发行在外普通股的加权平均数	638,565,671.00
稀释每股收益	<u>3.11</u>
其中:	
— 持续经营基本每股收益:	3.11
— 终止经营基本每股收益:	-

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 合并范围的变更

(1) 非同一控制下的企业合并

如附注二的编制基础所述编制本备考合并财务报表时，假设本公司收购杭州众硅 64.69%的股份已于 2025 年 1 月 1 日完成，自 2025 年 1 月 1 日起纳入本备考合并财务报表合并范围。

杭州众硅于合并日的资产、负债账面价值及公允价值列示如下：

	2025 年 1 月 1 日 公允价值	2025 年 1 月 1 日 账面价值
货币资金	299,782,056.76	299,782,056.76
交易性金融资产	35,002,847.53	35,002,847.53
应收票据	202,009.77	202,009.77
应收款项	50,057,955.36	50,057,955.36
预付款项	4,300,592.28	4,300,592.28
其他应收款	202,789,638.96	202,789,638.96
存货	440,555,282.85	413,529,616.98
合同资产	4,471,790.38	4,471,790.38
其他流动资产	60,873,801.26	60,873,801.26
固定资产	22,101,414.37	17,760,567.35
在建工程	54,690.27	54,690.27
使用权资产	14,946,199.58	14,946,199.58
无形资产	319,437,372.91	674,738.58
长期待摊费用	2,930,496.75	2,930,496.75
其他非流动资产	7,109.73	7,109.73
减：短期借款	(125,107,704.45)	(125,107,704.45)
应付款项	(44,473,216.96)	(44,473,216.96)
合同负债	(39,366,707.17)	(39,366,707.17)
应付职工薪酬	(16,253,112.55)	(16,253,112.55)
应交税费	(1,540,036.96)	(1,540,036.96)
其他应付款	(8,907,654.40)	(8,907,654.40)
一年内到期的非流动负债	(13,700,655.36)	(13,700,655.36)
其他流动负债	(7,106,351.32)	(7,106,351.32)
租赁负债	(10,685,841.42)	(10,685,841.42)
预计负债	(495,210.12)	(495,210.12)
其他非流动负债	(3,000,000.00)	(3,000,000.00)
	<u>1,186,876,768.05</u>	<u>836,747,620.83</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 合并范围的变更(续)

(1) 非同一控制下的企业合并(续)

无形资产、存货及固定资产的公允价值与账面价值的差额系由于本次重组按合并日公允价值作为初始成本。

合并成本以及商誉的确认情况见附注二(3)(viii)。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 在其他主体中的权益

(1) 在主要子公司中的权益

(a) 本备考主体的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	直接持股比例	取得方式
中微惠创科技(上海)有限公司	中国	上海	16,500,000	产品制造及贸易销售	100%	投资设立
中微半导体设备(厦门)有限公司	中国	福建	20,000,000	产品制造及贸易销售	100%	投资设立
南昌中微半导体设备有限公司	中国	南昌	25,000,000	产品制造及贸易销售	100%	投资设立
中微汇链科技(上海)有限公司	中国	上海	10,000,000	技术服务	80%	投资设立
中微半导体(上海)有限公司	中国	上海	4,000,000,000	产品制造及贸易销售	100%	投资设立
中微科技投资管理(上海)有限公司	中国	上海	300,000,000	投资管理	100%	投资设立
芯汇康生命科学(上海)有限公司	中国	上海	10,000,000	产品制造及贸易销售	100%	投资设立
中微半导体设备(广州)有限公司	中国	广州	300,000,000	产品制造及贸易销售	100%	投资设立
超微半导体设备(上海)有限公司(i)	中国	上海	160,000,000	产品制造及贸易销售	47%	投资设立
无锡正海缘宇创业投资合伙企业	中国	无锡	130,000,000	投资管理	98%	投资设立
中微半导体设备(四川)有限公司(ii)	中国	成都	100,000,000	产品制造及贸易销售	100%	投资设立
杭州众硅电子科技有限公司(附注二)	中国	杭州	115,620,108	产品制造及贸易销售	77%	外部并购

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 在其他主体中的权益(续)

(1) 在主要子公司中的权益(续)

(a) 本备考主体的构成(续)

- (i) 本公司于 2024 年与其他股东投资设立中微超微。于 2025 年 12 月 31 日，中微超微的注册资本为 160,000,000.00 元，其中本公司、本备考主体关键管理人员及其他关联方对中微超微的持股比例分别为 47.19%、21.21%及 1.24%。本公司与中微超微的部分其他股东(包括本备考主体关键管理人员)签署表决权委托协议使得本公司在中微超微的表决权达到 66.30%，可以单方面主导其重大财务和投资经营决策，因此本公司将中微超微作为本公司子公司核算。
- (ii) 本公司于 2025 年度以现金 100,000,000.00 元出资设立了控股子公司中微半导体设备(四川)有限公司。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 在其他主体中的权益(续)

(2) 在联营企业中的权益

(a) 不重要联营企业的汇总信息

本备考主体综合考虑合营企业和联营企业是否为上市公司、其账面价值占本备考主体合并总资产的比例、权益法核算的长期股权投资收益占本备考主体合并净利润的比例等因素，确定重要的联营企业，本备考主体无重要的联营企业。

不重要联营企业列示如下：

2025 年度

联营企业：

投资账面价值合计	1,444,770,418.51
下列各项按持股比例计算的合计数	
净利润(i)	51,879,829.04
其他综合损失(i)	(3,302,101.00)
综合收益总额	48,577,728.04

(i) 净利润和其他综合损失均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

八 关联方关系及其交易

(1) 第一大股东情况

(a) 第一大股东基本情况

于 2025 年 12 月 31 日，本公司第一大股东为上海创业投资有限公司。

(b) 第一大股东对本公司的直接持股比例

	2025 年 12 月 31 日	
	投入资本	持股比例
上海创业投资有限公司	<u>93,483,533.00</u>	<u>14.93%</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(2) 子公司情况

子公司的基本情况及相关信息见附注七(1)。

(3) 不存在控制关系的关联方

	与本公司关系
尹志尧	本公司董事长兼任总经理
上海智微攀峰创业投资合伙企业(有限合伙)	联营企业(自 2025 年 8 月开始)
上海芯元基半导体科技有限公司	联营企业
拓荆科技股份有限公司	联营企业
睿励科学仪器(上海)有限公司	联营企业
成都英杰晨晖科技有限公司	联营企业
杭州众硅电子科技有限公司	联营企业(自 2025 年 8 月开始)
苏州索雷尔科技有限公司	联营企业之子公司
拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司	联营企业之子公司
拓荆科技(上海)有限公司	联营企业之子公司
拓荆键科(海宁)半导体设备有限公司	联营企业之子公司
安徽芯元基半导体科技有限责任公司	联营企业之子公司
客户 A	关联公司董事曾任本公司董事(截止期后)
深圳市志橙半导体材料股份有限公司	关联公司董事曾任本公司董事(截止期后)
公司 1	由本公司董事担任董事的公司(自 2025 年 9 月开始)
公司 2	由本公司董事担任董事的公司(自 2025 年 9 月开始)
上海华力微电子有限公司	由本公司董事担任董事的公司(自 2025 年 4 月开始)
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	由本公司监事担任董事的公司
盛美半导体设备(上海)股份有限公司	由本公司监事担任董事的公司
上海华力集成电路制造有限公司	由本公司董事担任董事的公司之子公司 (自 2025 年 4 月开始)
BEAMVISION PTE. LTD.	由本公司监事担任董事的公司(截止 2026 年 9 月)
厦门通富微电子有限公司	由本公司董事担任董事的公司之子公司
上海现代先进超精密制造中心有限公司	由本公司董事担任董事的公司之子公司
北京华丞电子有限公司	由本公司董事担任董事的公司之子公司
盛帷半导体设备(上海)有限公司	由本公司监事担任董事的公司之子公司
上海智微私募基金管理有限公司	关联公司董事曾任本公司高管(自 2025 年 2 月开始)
中科九微科技股份有限公司	关联公司前高管曾任本公司董事(截止 2025 年 8 月)
公司 A	关联方母公司董事曾任本公司董事
南昌昂坤半导体设备有限公司	关联方母公司董事曾任本公司董事
世源科技工程有限公司	关联方母公司董事曾任本公司董事
北京希达工程管理咨询有限公司	关联方母公司董事曾任本公司董事
公司 3	受本备考主体重大影响
上海集成电路研发中心有限公司	关联公司前董事曾任本公司董事(截止 2024 年 1 月)
盛合晶微半导体(江阴)有限公司	关联公司前董事曾任本公司董事(截止 2024 年 3 月)
格科半导体(上海)有限公司	关联方母公司董事曾任本公司董事(截止 2024 年 3 月)
上海中欣晶圆半导体科技有限公司	关联方母公司董事曾任本公司董事(截止 2024 年 8 月)

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(4) 关联交易

(a) 购销商品、提供和接受劳务

销售商品、提供劳务：

	关联交易内容	关联交易定价政策	2025 年度
公司 1	销售商品及提供服务	市场价格	459,889,683.01
公司 2	销售商品及提供服务	市场价格	227,108,187.89
客户 A	销售商品及提供服务	市场价格	113,102,528.79
上海华力集成电路制造有限公司	销售商品及提供服务	市场价格	40,972,086.03
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	销售商品及提供服务	市场价格	26,138,633.85
上海华力微电子有限公司	销售商品及提供服务	市场价格	7,652,729.43
公司 3	销售商品及提供服务	市场价格	7,054,295.11
深圳市志橙半导体材料股份有限公司	销售商品及提供服务	市场价格	4,197,786.28
拓荆科技(上海)有限公司	销售商品及提供服务	市场价格	2,769,970.80
厦门通富微电子有限公司	销售商品及提供服务	市场价格	1,877,683.98
拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司	销售商品及提供服务	市场价格	1,320,733.50
盛帷半导体设备(上海)有限公司	销售商品及提供服务	市场价格	710,094.34
睿励科学仪器(上海)有限公司	销售商品及提供服务	市场价格	609,438.97
			<u>893,403,851.98</u>

采购商品、接受劳务：

	关联交易内容	关联交易定价政策	2025 年度
成都英杰晨晖科技有限公司	采购商品及接受服务	市场价格	73,297,046.70
深圳市志橙半导体材料股份有限公司	采购商品及接受服务	市场价格	23,020,894.99
睿励科学仪器(上海)有限公司	采购商品及接受服务	市场价格	19,860,824.92
公司 A	采购商品及接受服务	市场价格	19,325,429.50
公司 3	采购商品及接受服务	市场价格	18,186,865.96
南昌昂坤半导体设备有限公司	采购商品及接受服务	市场价格	14,672,815.53
世源科技工程有限公司	采购商品及接受服务	市场价格	7,167,687.53
盛美半导体设备(上海)股份有限公司	采购商品及接受服务	市场价格	4,225,724.96
上海智微私募基金管理有限公司	采购商品及接受服务	市场价格	2,000,000.00
拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司	采购商品及接受服务	市场价格	1,260,554.09
中科九微科技股份有限公司	采购商品及接受服务	市场价格	347,324.00
北京希达工程管理咨询有限公司	采购商品及接受服务	市场价格	298,125.00
上海现代先进超精密制造中心有限公司	采购商品及接受服务	市场价格	86,000.00
北京华丞电子有限公司	采购商品及接受服务	市场价格	64,660.00
安徽芯元基半导体科技有限责任公司	采购商品及接受服务	市场价格	12,619.87
			<u>183,826,573.05</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(4) 关联交易(续)

(b) 关键管理人员薪酬

2025 年度

关键管理员工资	74,482,569.00
关键管理人员股份支付费用	46,732,786.00
	<u>121,215,355.00</u>

(c) 收到关联方发放股利

2025 年度

拓荆科技股份有限公司	<u>5,539,402.35</u>
------------	---------------------

(d) 向关联方投资

2025 年度

上海智微攀峰创业投资合伙企业(有限合伙)	514,500,000.00
杭州众硅电子科技有限公司	235,348,846.45
苏州索雷尔科技有限公司	20,000,000.00
上海智微私募基金管理有限公司	4,500,000.00
	<u>774,348,846.45</u>

(e) 租赁

本备考集团作为出租方直接计入当期损益的短期租赁和低价值租赁的租金收入：

承租方名称	租赁资产种类	2025 年度
公司 3	办公室	<u>3,290,637.47</u>

本备考集团作为承租方直接计入当期损益的短期租赁和低价值租赁的租金费用：

出租方名称	租赁资产种类	2025 年度
上海华力集成电路制造有限公司	办公室	<u>169,660.26</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联方余额

(a) 应收账款

	2025 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备
客户 A	121,519,051.19	(1,505,488.72)
公司 1	109,800,639.30	(4,493,625.19)
公司 2	86,486,523.30	(5,180,558.11)
上海集成电路装备材料产业创新中心 有限公司	37,118,490.71	(597,377.28)
上海华力集成电路制造有限公司	27,373,544.02	(565,415.81)
上海华力微电子有限公司	5,255,495.11	(137,070.29)
公司 3	4,851,129.24	(127,312.26)
上海芯元基半导体科技有限公司	3,690,035.86	(2,099,475.75)
睿励科学仪器(上海)有限公司	2,093,667.48	(993,972.64)
拓荆科技(上海)有限公司	741,538.40	(19,460.81)
深圳市志橙半导体材料股份有限公司	681,090.72	(17,874.44)
厦门通富微电子有限公司	591,717.41	(17,156.59)
拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司	221,407.20	(5,810.58)
盛帷半导体设备(上海)有限公司	210,849.06	(5,533.49)
	<u>400,635,179.00</u>	<u>(15,766,131.96)</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联方余额(续)

(b) 其他应收款

	2025 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备
关键管理人员	31,430,000.00	(333,158.00)
公司 3	4,691,629.04	(49,731.27)
BEAMVISION PTE. LTD.	1,980,000.00	(20,988.00)
	<u>38,101,629.04</u>	<u>(403,877.27)</u>

(c) 长期应收款

	2025 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备
公司 3	<u>1,291,979.71</u>	<u>-</u>

(d) 预付款项

	2025 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备
上海华力集成电路制造有限公司	1,386,950.24	-
睿励科学仪器(上海)有限公司	561,182.67	-
	<u>1,948,132.91</u>	<u>-</u>

(e) 其他非流动资产

	2025 年 12 月 31 日
睿励科学仪器(上海)有限公司	<u>2,931,009.60</u>

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联方余额(续)

(f) 应付账款

2025 年 12 月 31 日

成都英杰晨晖科技有限公司	31,360,553.90
睿励科学仪器(上海)有限公司	13,296,710.00
深圳市志橙半导体材料股份有限公司	5,456,089.72
南昌昂坤半导体设备有限公司	2,967,430.40
公司 A	2,276,046.00
中科九微科技股份有限公司	1,495,159.00
拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司	434,379.84
北京华丞电子有限公司	13,560.00
	<u>57,299,928.86</u>

(g) 合同负债

2025 年 12 月 31 日

公司 1	233,131,836.20
客户 A	100,343,612.78
厦门通富微电子有限公司	11,150,442.48
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	1,336,049.62
	<u>345,961,941.08</u>

(h) 其他应付款

2025 年 12 月 31 日

公司 3	2,355,835.52
世源科技工程有限公司	1,882,609.23
上海华力集成电路制造有限公司	42,415.13
	<u>4,280,859.88</u>

九 或有事项

于资产负债表日，本备考主体无需要披露的重要或有事项。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十 承诺事项

(1) 资本性支出承诺事项

(a) 已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺

2025 年 12 月 31 日

房屋、建筑物及机器设备

290,461,601.34

十一 股份支付

(1) 以权益结算的股份支付

(a) 概要

(i) 2022 年第二类限制性股票激励计划

根据 2022 年 3 月 25 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(“激励计划方案”), 本公司向激励对象实施限制性股票激励计划, 共授予激励对象 400 万股第二类限制性股票。授予价格为 50 元/股。

根据本激励计划方案, 激励对象自首次授予之日起 4 年内, 每年归属权益数量占授予权益总量的 25%, 且每次权益归属以满足相应的归属条件为前提(包括公司业绩条件及个人业绩条件)。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一 股份支付(续)

(1) 以权益结算的股份支付(续)

(a) 概要(续)

(ii) 2023 年第二类限制性股票激励计划

根据 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会决议通过的《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(“激励计划方案”), 本公司向激励对象实施限制性股票激励计划, 共授予激励对象 550 万股第二类限制性股票。授予价格为 50 元/股。

根据本激励计划方案, 激励对象自首次授予之日起 4 年内, 每年归属权益数量占授予权益总量的 25%, 且每次权益归属以满足相应的归属条件为前提(包括公司业绩条件及个人业绩条件)。

(iii) 2024 年第二类限制性股票激励计划

根据 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会决议通过的《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(“激励计划方案”), 本公司向激励对象实施限制性股票激励计划, 共授予激励对象 880 万股第二类限制性股票。授予价格为 76.1 元/股。

根据本激励计划方案, 激励对象自首次授予之日起 4 年内, 每年归属权益数量占授予权益总量的 25%, 且每次权益归属以满足相应的归属条件为前提(包括公司业绩条件及个人业绩条件)。

(iv) 2025 年第二类限制性股票激励计划

根据 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会决议通过的《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(“激励计划方案”), 本公司向激励对象实施限制性股票激励计划, 共授予激励对象 1000 万股第二类限制性股票。授予价格为 100 元/股。

根据本激励计划方案, 激励对象自首次授予之日起 4 年内, 每年归属权益数量占授予权益总量的 25%, 且每次权益归属以满足相应的归属条件为前提(包括公司业绩条件及个人业绩条件)。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一 股份支付(续)

(1) 以权益结算的股份支付(续)

(b) 2025 年度限制性股票变动情况表

	2025 年度	加权平均行权价格
年初发行在外	14,070,554	65.38 元/股
本年授予	10,000,000	100.00 元/股
本年行权	(3,781,572)	62.59 元/股
本年失效	(1,848,584)	71.84 元/股
年末发行在外	<u>18,440,398</u>	<u>83.93 元/股</u>

于 2025 年 12 月 31 日，本年已归属但尚未行权的限制性股票为 261,928 股，加权平均行权价格为 63.14 元/股。

(c) 以权益结算的股份支付确认的费用金额如下：

	2025 年度
研发费用	260,601,149.12
管理费用	117,684,486.55
销售费用	103,326,613.85
营业成本	<u>44,468,943.40</u>
	<u>526,081,192.92</u>

于 2025 年 12 月 31 日，发行在外的限制性股票加权平均行权价格为 83.93 元/股，限制性股票加权平均合同剩余期限为 2.50 年。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一 股份支付(续)

(1) 以权益结算的股份支付(续)

(d) 授予日限制性股票公允价值的确定方法

本备考主体采用二叉树模型确定授予日限制性股票的公允价值。

于 2025 年度授予日，第二类限制性股票激励计划的主要估值参数分别列示如下：

	2025 年度
行权价格	100.00 元/股
限制性股票的有效期限	2-5 年
标的股份的现行价格	171.30 元/股
股价预计波动率	45.55%-50.48%
有效期内的无风险利率	1.41-1.50%
预计股息率	0.18%

中微半导体设备(上海)股份有限公司

备考合并财务报表补充资料

2025 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 非经常性损益明细表

	2025 年度
非流动性资产处置收益	445,603,562.01
除同正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产产生的损益	177,929,101.04
除与正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响外，计入当期损益的政府补助	55,482,869.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(647,212.38)
	<u>678,368,320.34</u>
所得税影响额	(99,191,593.16)
少数股东权益影响额(税后)	21,169.09
	<u>579,197,896.27</u>

(1) 非经常性损益明细表编制基础

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2023 年修订)》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

本公司将与正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有且对本公司损益产生持续影响的政府补助计入当期损益的金额列报为经常性损益。

二 净资产收益率及每股收益

	加权平均 净资产收益率(%) 2025 年度	每股收益	
		基本每股收益 2025 年度	稀释每股收益 2025 年度
归属于公司普通股股东的净利润	8.77%	3.15	3.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.21%	2.23	2.21